

2024年度 第2四半期 決算説明資料

2024.10.17

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

(単位: 百万円)	FY2024 2Q
売上高	96,243
売上総利益	69,029
GP率	71.7%
販売管理費	26,454
営業利益	42,575
経常利益	41,429
経常利益率	43.0%
税前利益	41,317
純利益	29,729

FY2024 1Q	QoQ	
	差額	(%)
82,799	13,444	16.2%
57,699	11,331	19.6%
69.7%	2.0p	-
24,322	2,132	8.8%
33,376	9,199	27.6%
33,623	7,805	23.2%
40.6%	2.4p	-
33,457	7,859	23.5%
23,713	6,016	25.4%

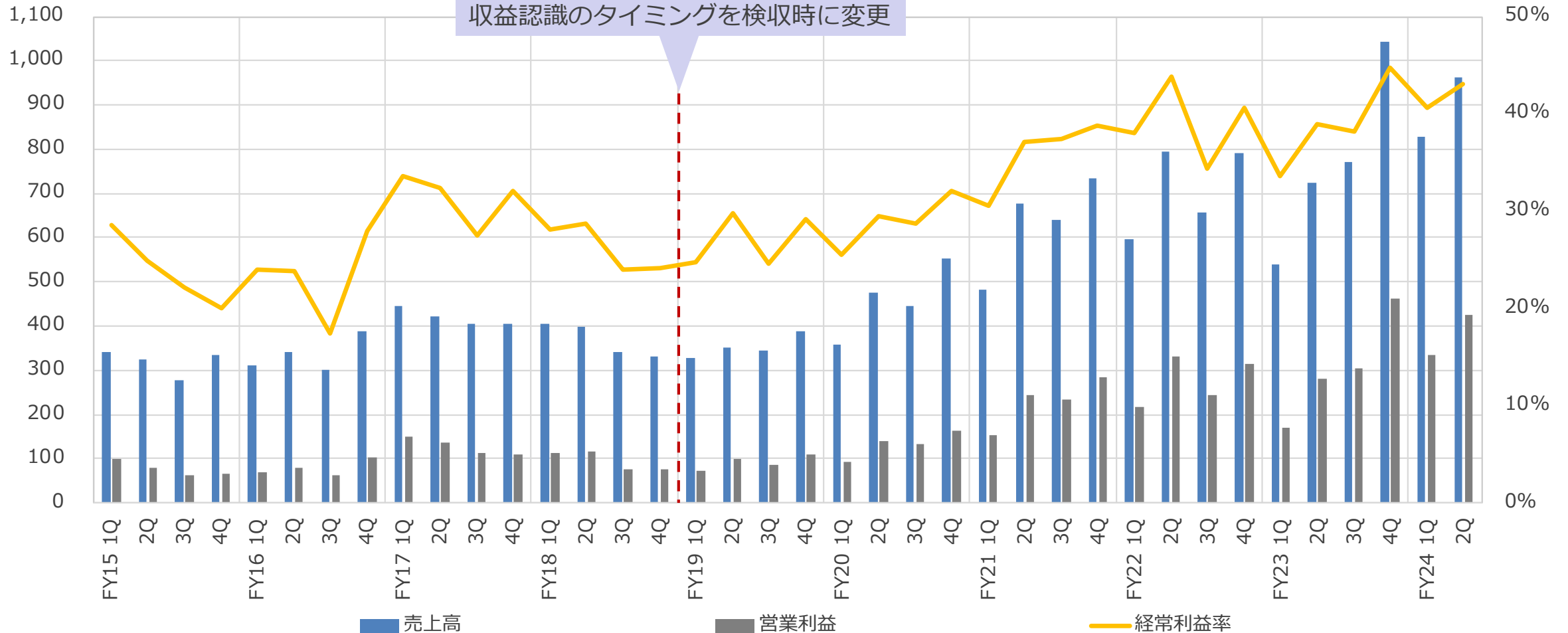
FY2023 2Q	YoY	
	差額	(%)
72,298	23,945	33.1%
49,480	19,549	39.5%
68.4%	3.3p	-
21,443	5,011	23.4%
28,037	14,538	51.9%
28,114	13,314	47.4%
38.9%	4.1p	-
28,106	13,210	47.0%
20,026	9,703	48.5%

売上高: 高水準の出荷と装置検収の進捗により大幅増
 GP率: 高単価・高付加価値製品等が寄与し上昇
 販売管理費: 人件費や研究開発費を中心に増加

(単位：百万円)	FY2024	FY2023	YoY	
	1H	1H	差額	(%)
売上高	179,043	126,260	52,783	41.8%
売上総利益	126,728	84,662	42,066	49.7%
GP率	70.8%	67.1%	3.7p	-
販売管理費	50,776	39,652	11,123	28.1%
営業利益	75,952	45,009	30,943	68.7%
経常利益	75,052	46,277	28,775	62.2%
経常利益率	41.9%	36.7%	5.2p	-
税前利益	74,775	46,246	28,529	61.7%
純利益	53,443	32,708	20,735	63.4%

売上高： 高水準の出荷と装置検収の進捗により大幅増加
 GP率： 高単価・高付加価値製品等が寄与し70%台を記録
 販売管理費： 人件費や研究開発費を中心に増加

(単位：億円)

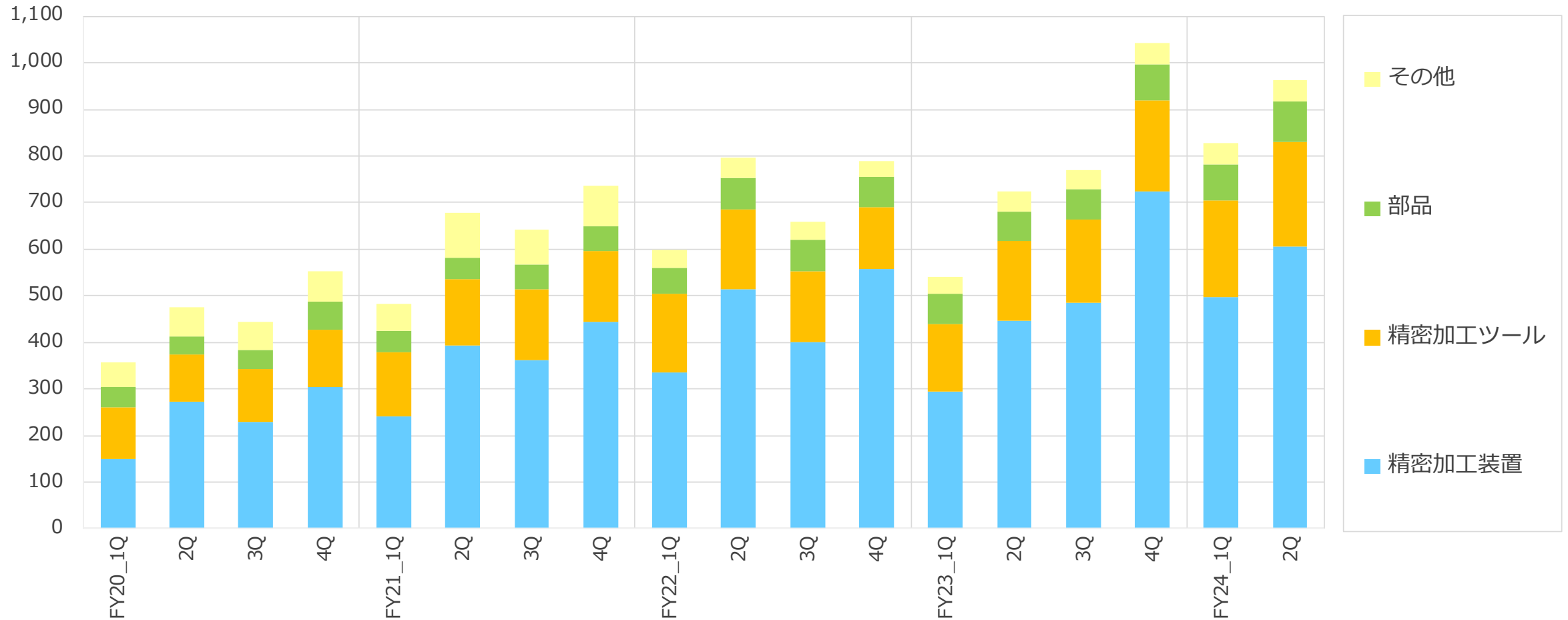


会計方針変更により
収益認識のタイミングを検収時に変更

高いG P率を背景に営業利益率は四半期最高水準を記録
(FY24_2Q 営業利益率44.2% 経常利益率43.0% 純利益率30.9%)

製品群別売上高 四半期推移

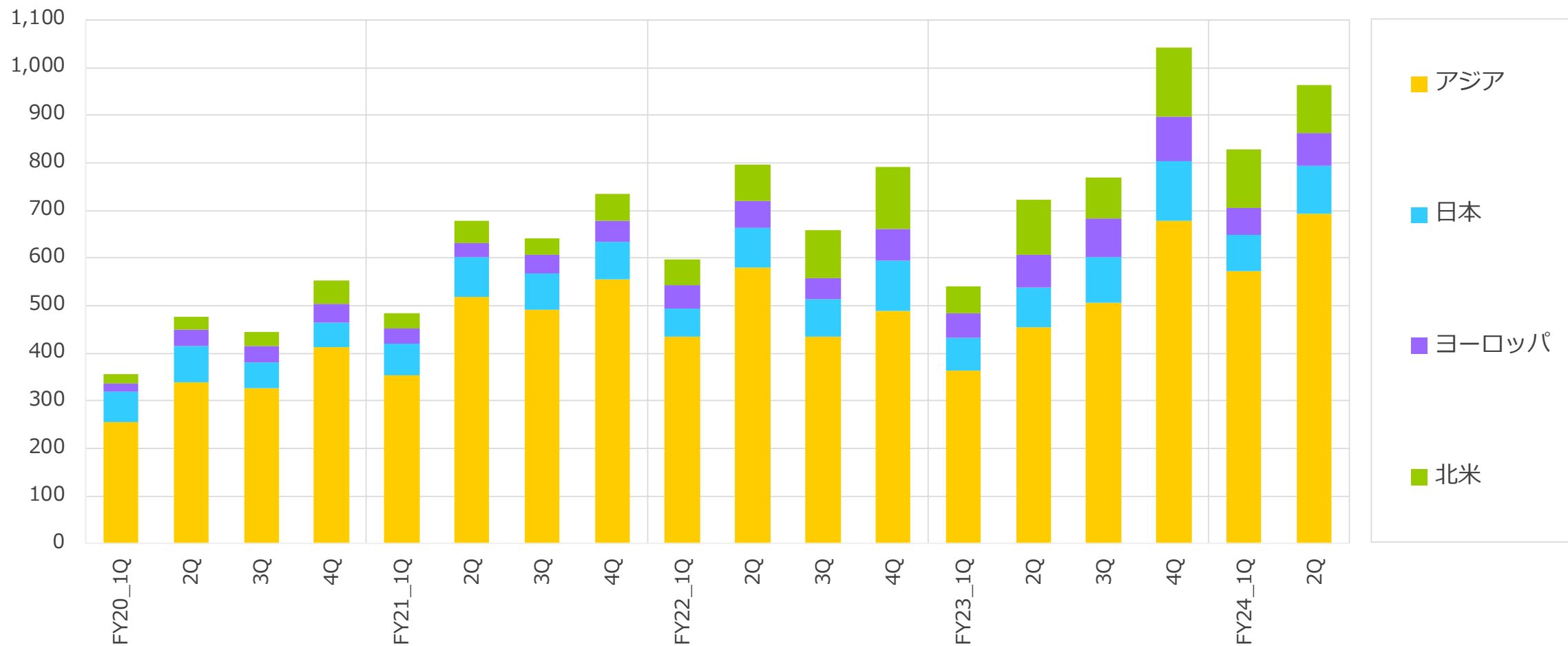
(単位：億円)



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

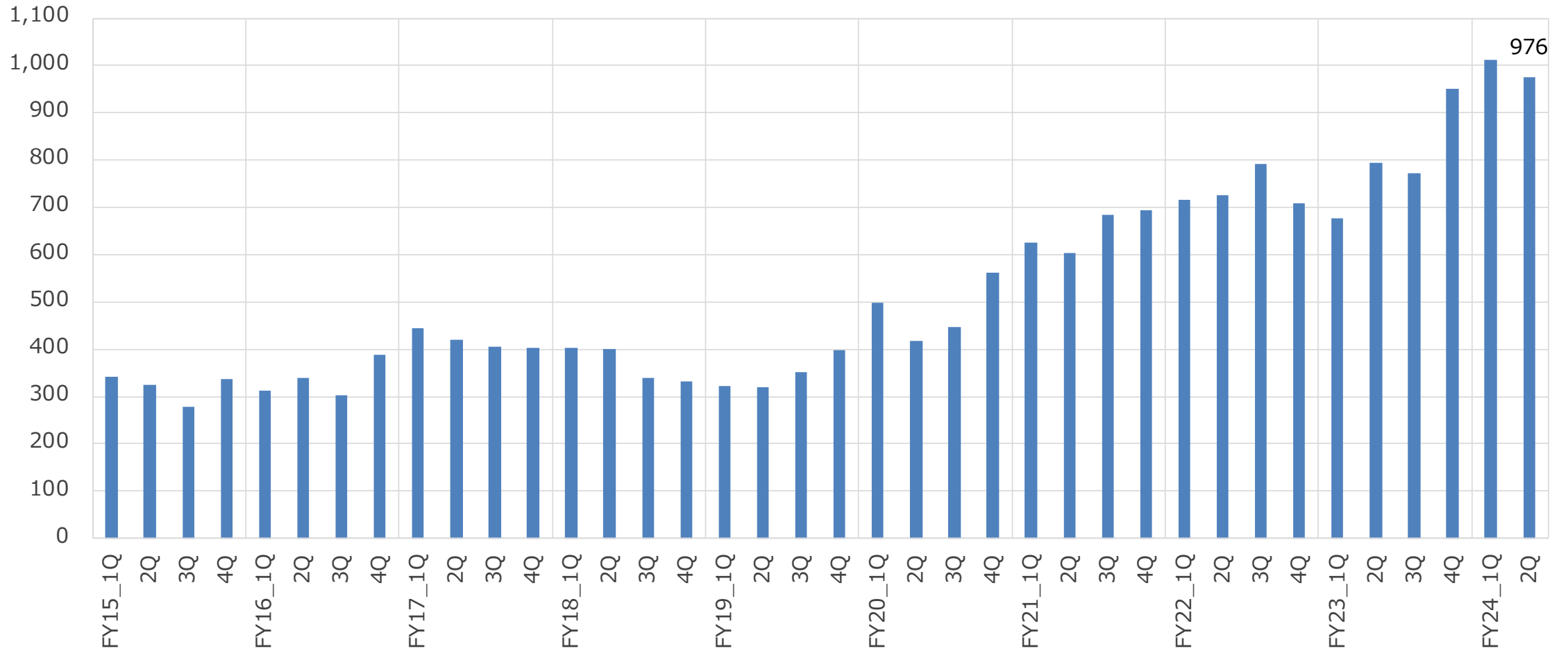
地域別売上高 四半期推移

(単位：億円)



FY24_2Q 海外売上高比率 89.4%

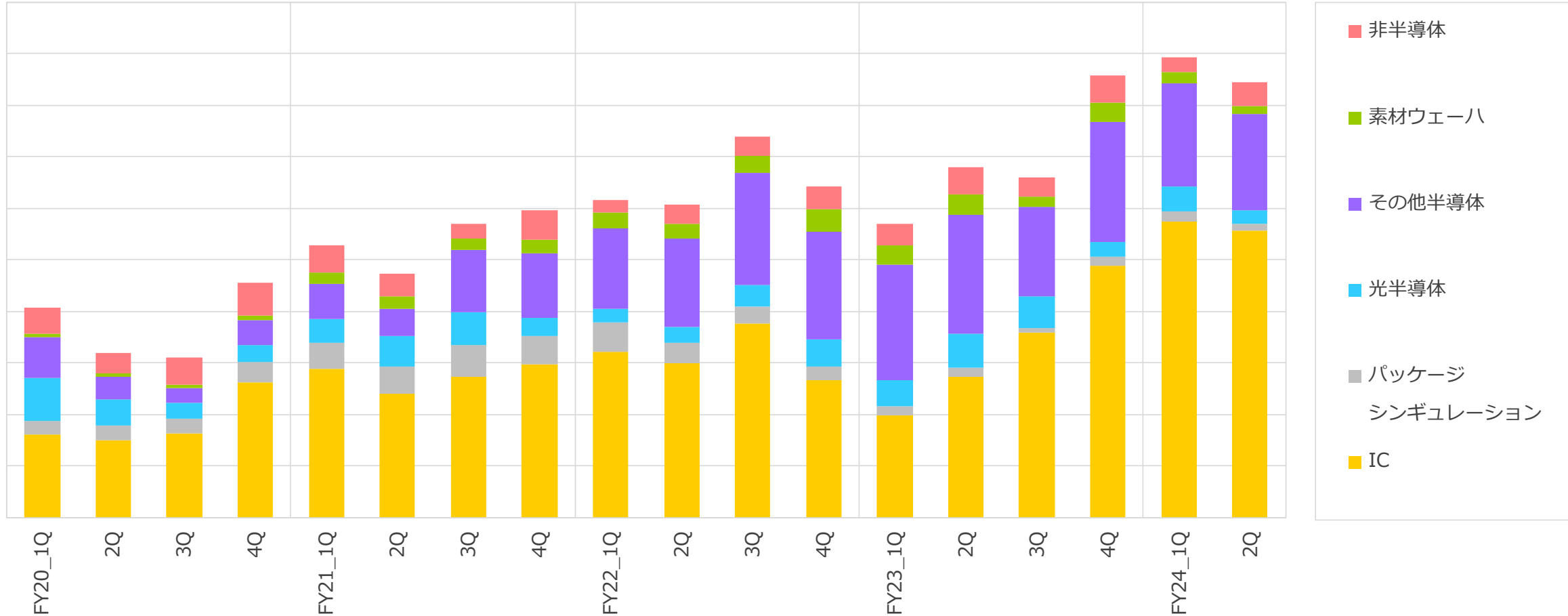
(単位：億円)



FY24_2Q 出荷額 約976億円

出荷額ベース

精密加工装置

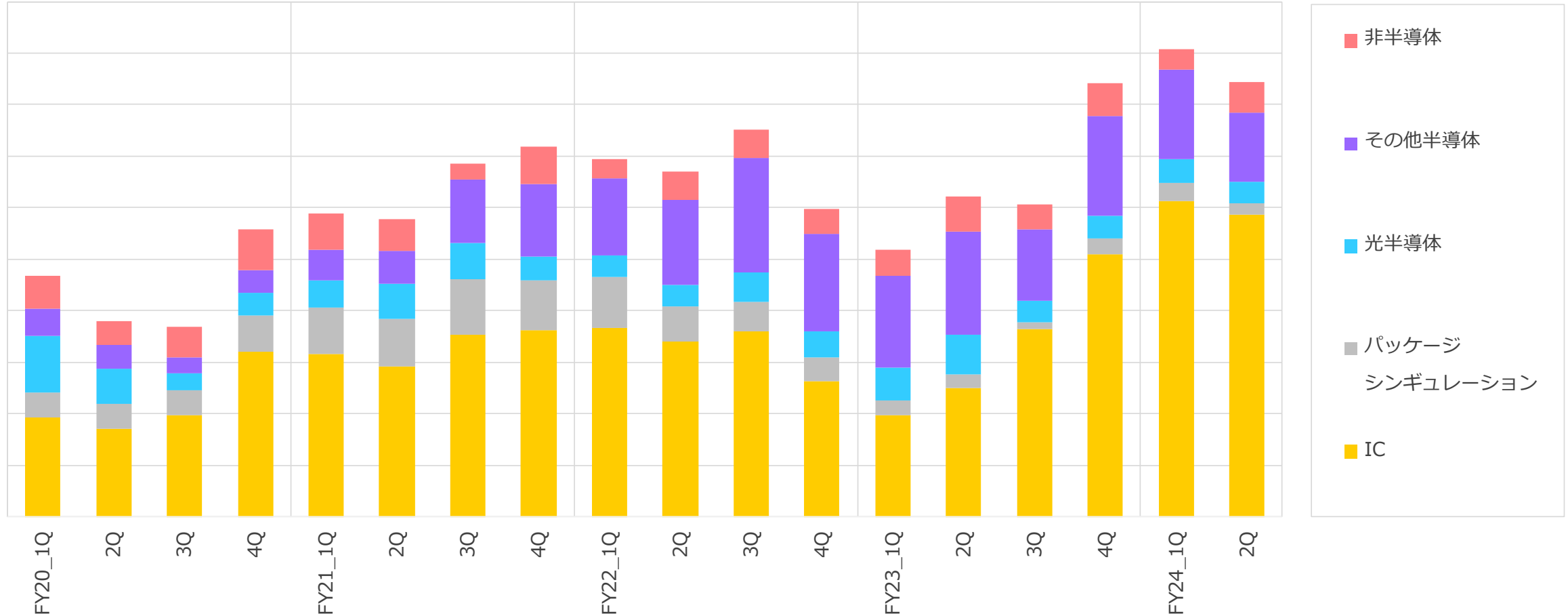


QoQ
YoY

生成AI向けを中心にIC向けが高水準を維持
生成AIの需要拡大を背景にIC向けが増加

出荷額ベース

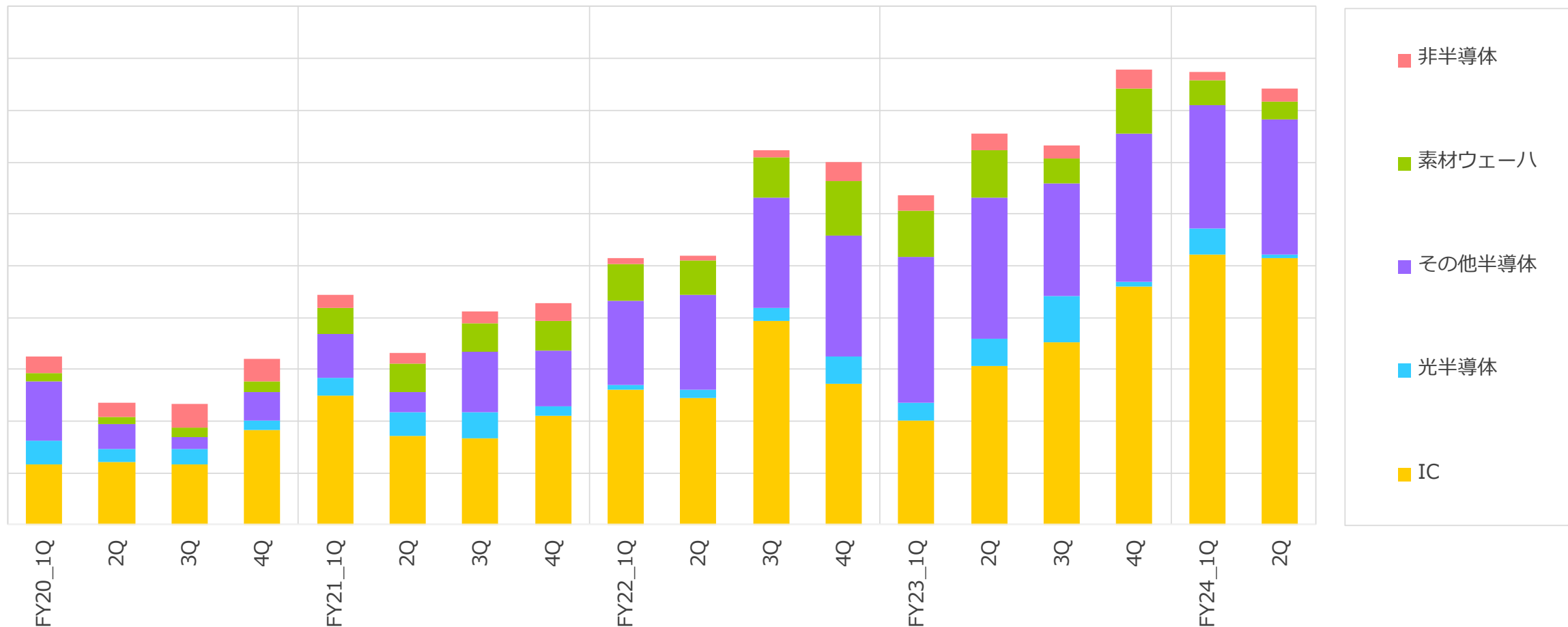
ダイサ



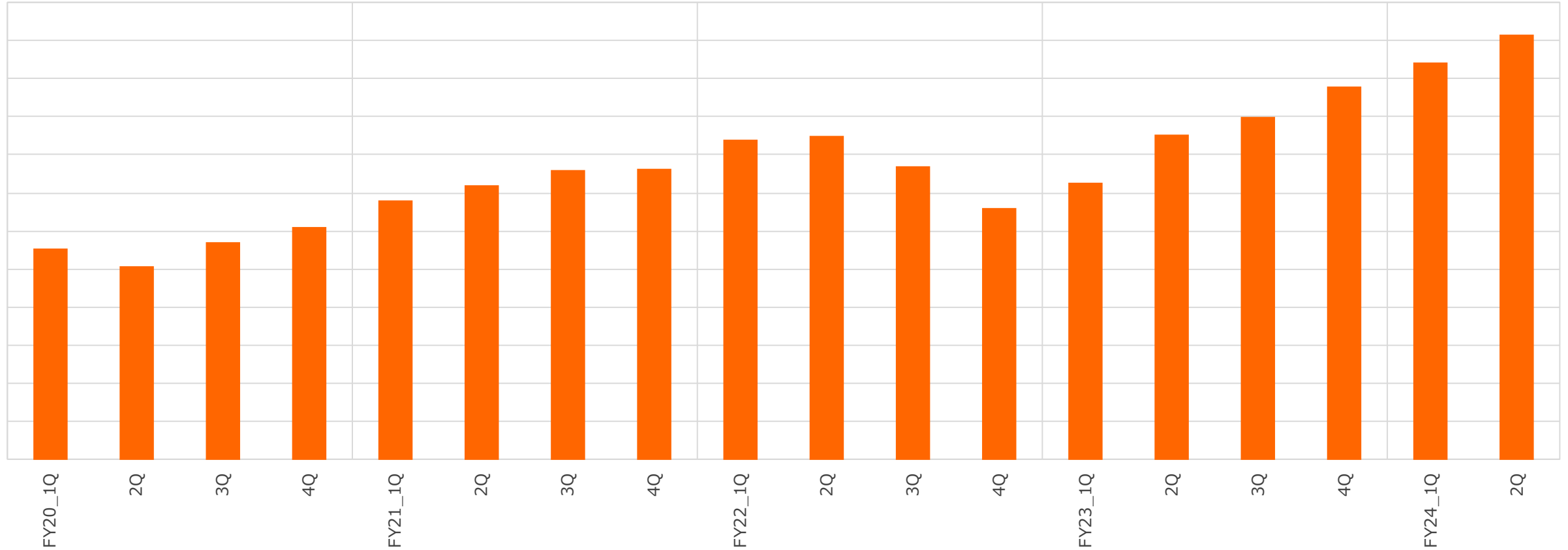
QoQ 生成AI向けを中心にIC向けが高水準を維持
 YoY 生成AI需要の拡大によりIC向けが大幅増となった

出荷額ベース

グラインダ



QoQ 生成AI向けを中心にICとその他半導体（主にパワー半導体）が高水準を維持
 YoY 生成AI需要の拡大によりIC向けが大幅増となった



精密加工ツール（消耗品）の出荷は堅調に推移
為替変動の影響を受けるも顧客の設備稼働率の上昇等を背景に過去最高を更新

(単位：百万円)	FY2024 2Q	FY2024 1Q	差額
現金及び預金	243,571	218,326	25,244
受取手形・売掛金	40,586	42,393	-1,806
棚卸資産	130,278	124,394	5,884
流動資産	420,812	388,862	31,950
有形固定資産	149,623	150,294	-670
固定資産	170,185	170,064	121
総資産	590,998	558,927	32,070
流動負債	153,706	150,959	2,748
固定負債	763	811	-48
負債合計	154,470	151,770	2,700
純資産	436,527	407,157	29,370
負債純資産合計	590,998	558,927	32,070
自己資本比率	73.6%	72.6%	1.0p

総資産：主に現預金や棚卸資産が増加

負債：電子記録債務が減少した一方、未払法人税等が大幅に増加

純資産：主に利益剰余金が増加

(単位：百万円)	FY2024 1H	FY2023 1H	差額
営業キャッシュ・フロー	60,948	41,509	19,439
税前当期利益	74,775	46,246	28,529
減価償却	5,680	5,201	478
売上債権の増減	5,105	5,214	-109
棚卸資産の増減	-16,721	-13,447	-3,274
仕入債務の増減	-537	4,843	-5,381
法人税支払い	-19,864	-15,750	-4,114
その他営業CF	12,510	9,200	3,310
投資キャッシュ・フロー	-7,114	-7,627	514
有形固定資産の取得	-7,121	-7,487	366
フリー・キャッシュ・フロー	53,834	33,881	19,953
財務キャッシュ・フロー	-24,934	-22,764	-2,170
配当金支払い	-24,996	-22,881	-2,115
現金同等物増減	28,084	12,794	15,290
期首残高	215,486	163,053	52,433
期末残高	243,571	175,847	67,724

- 営業CF・・・約609億円 資金増加
主に税前利益による資金増加
 - 投資CF・・・約71億円 資金減少
主に有形固定資産の取得によるもの
 - フリー・キャッシュ・フロー
約538億円の資金増加
 - 財務CF・・・約249億円 資金減少
主に配当金の支払い
- 9月末の現金残高 約2,435億円

(単位：億円)

今回予想

	FY23 1Q	2Q	3Q	4Q	FY24 1Q	2Q	3Q
売上高	540	723	770	1,043	828	962	839
営業利益	170	280	304	461	334	426	292
経常利益	182	281	294	467	336	414	295
純利益	127	200	161	354	237	297	208
営業利益率	31.5%	38.8%	39.4%	44.2%	40.3%	44.2%	34.9%
経常利益率	33.7%	38.9%	38.2%	44.7%	40.6%	43.0%	35.2%
純利益率	23.5%	27.7%	20.9%	34.0%	28.6%	30.9%	24.8%
出荷額	678	794	773	950	1,011	976	992

※億円未満 四捨五入

想定為替レート 3Q (10-12月期)
為替感応度 (年換算)

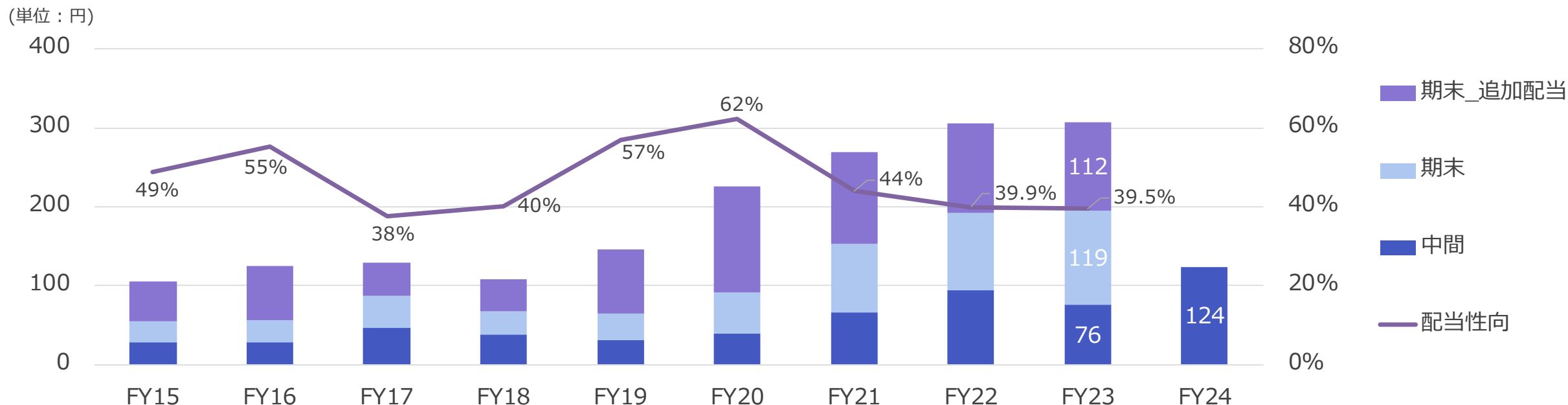
US\$: 135円
US\$: 約15億円

Euro : 150円
Euro : 約1億円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など

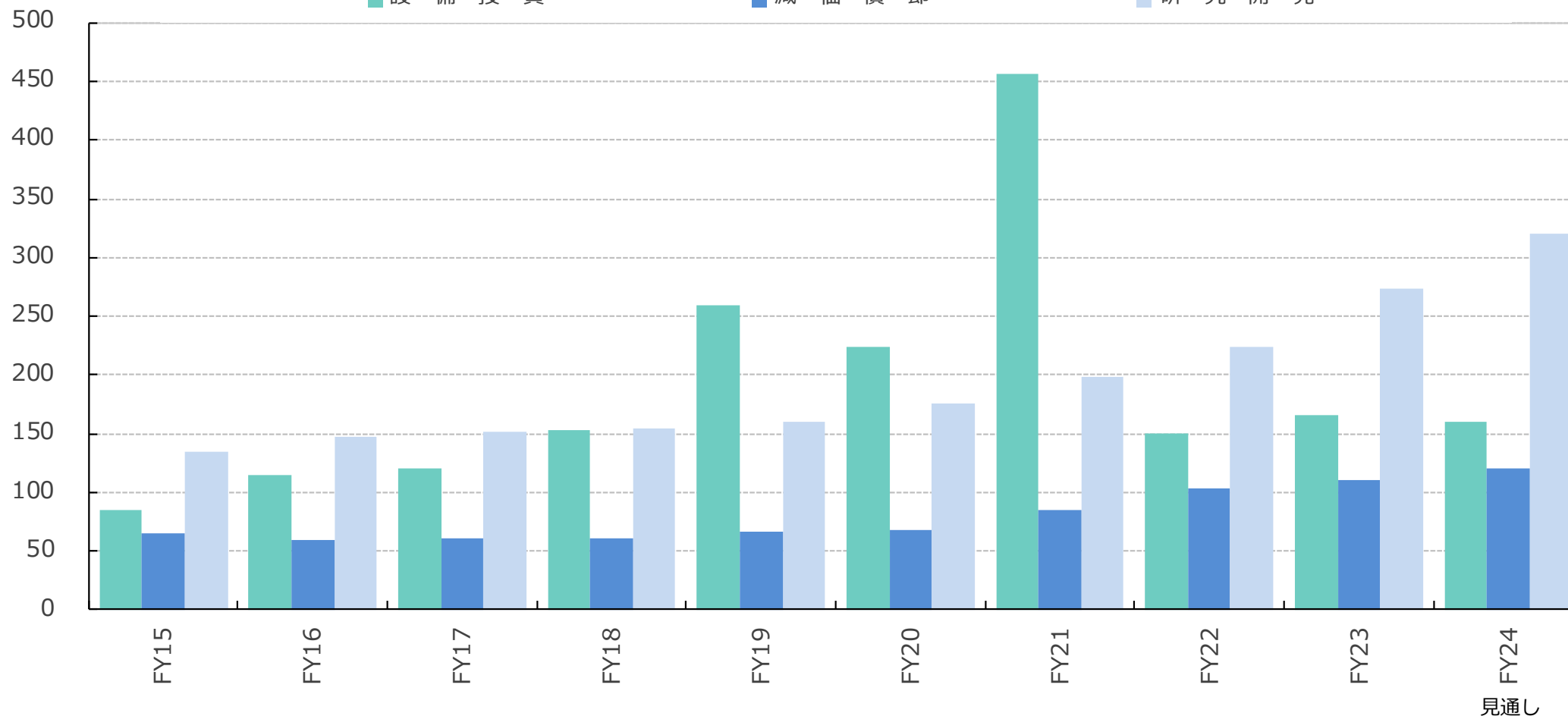


FY24 中間（実績）124円 期末：未定

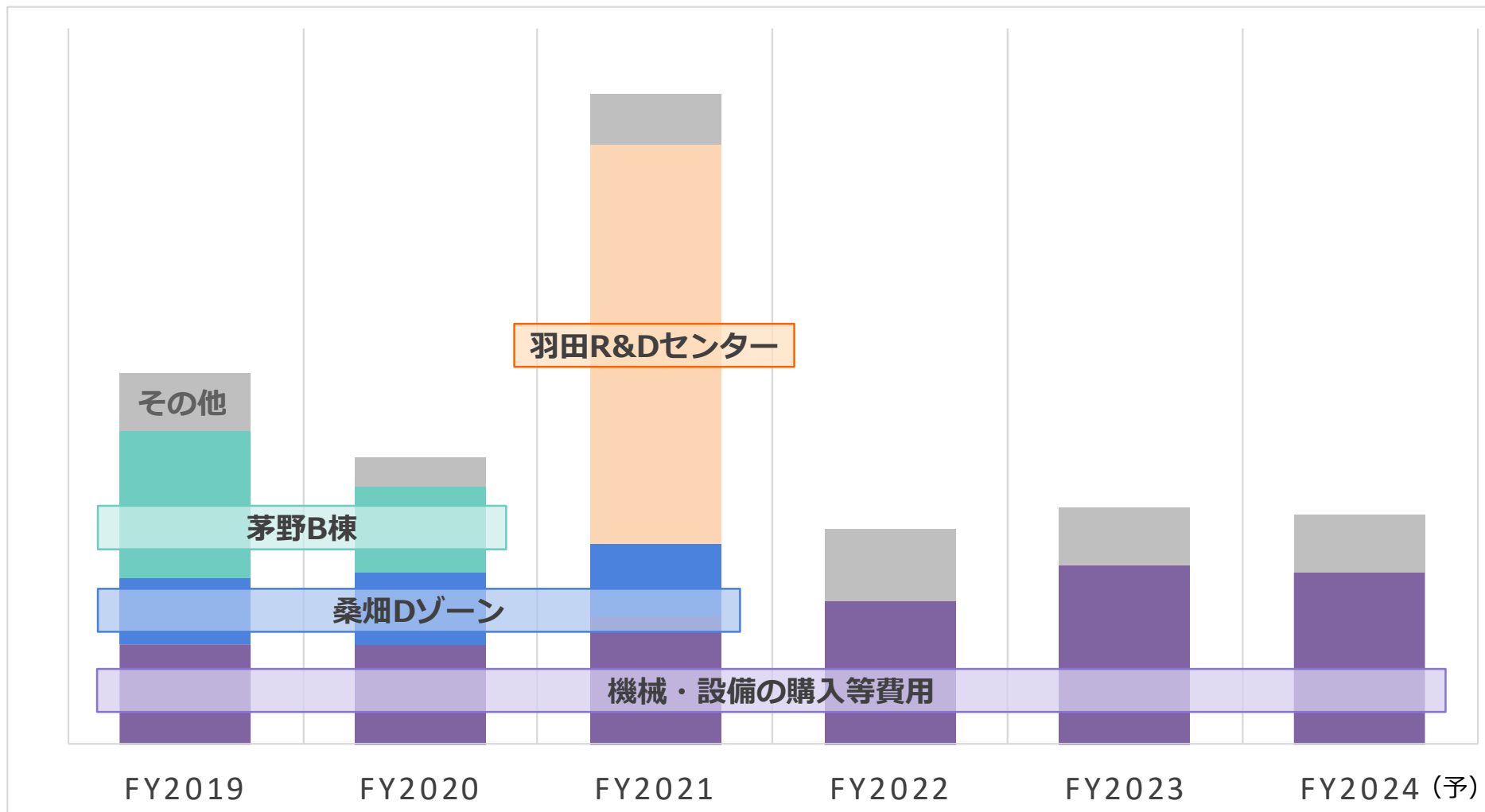
※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施
（FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載）

(単位：億円)

■ 設備投資 ■ 減価償却 ■ 研究開発



FY24見通し 設備投資：約160億円 主に合理化投資を実施（羽田R&Dセンター新棟はFY25着工予定）
 減価償却：約120億円 前年度と同等か若干増を見込む
 研究開発：約320億円 積極的な研究開発を継続



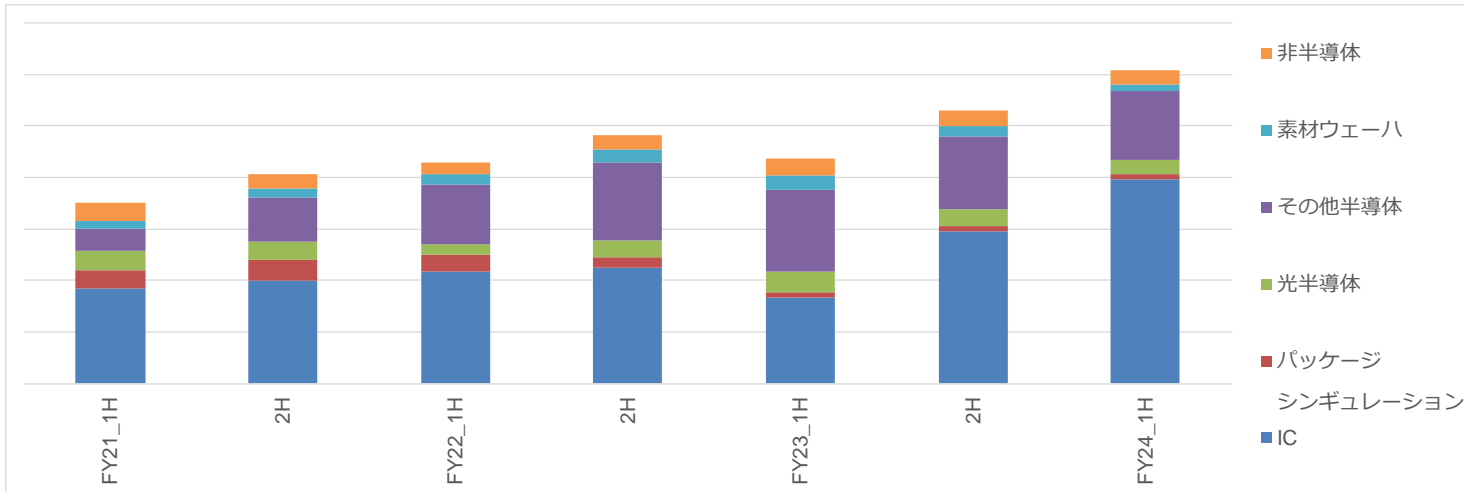
FY24見通し
 機械・設備の購入等費用 約120億円
 他 オフィス拡張など 約40億円
 (羽田R&Dセンター新棟は2025年4月着工予定)

出荷額ベース

製品群		見通し FY24_3Q 増減率 (QoQ)
ダイサ	ブレードダイサ	25%
	レーザーソー	-15%
	ダイサ	5%
	グラインダ	25%
	周辺装置	0%
精密加工装置		10%
精密加工ツール		-15%
その他		-15%

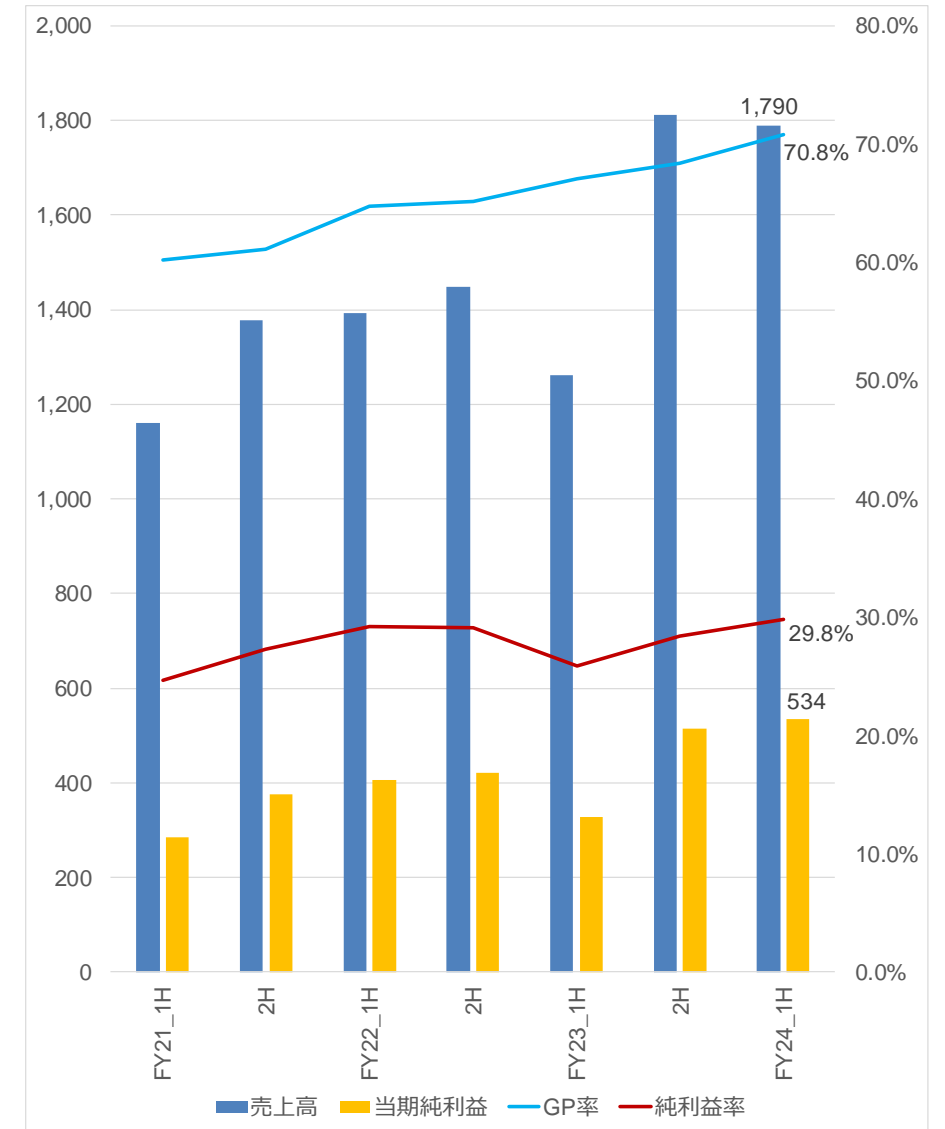
- 出荷動向：半期ベースで過去最高を記録
P C・スマホ向け需要は本格回復に至らず
パワー半導体と生成A I 向けの装置出荷が高水準

(分類：その他半導体)

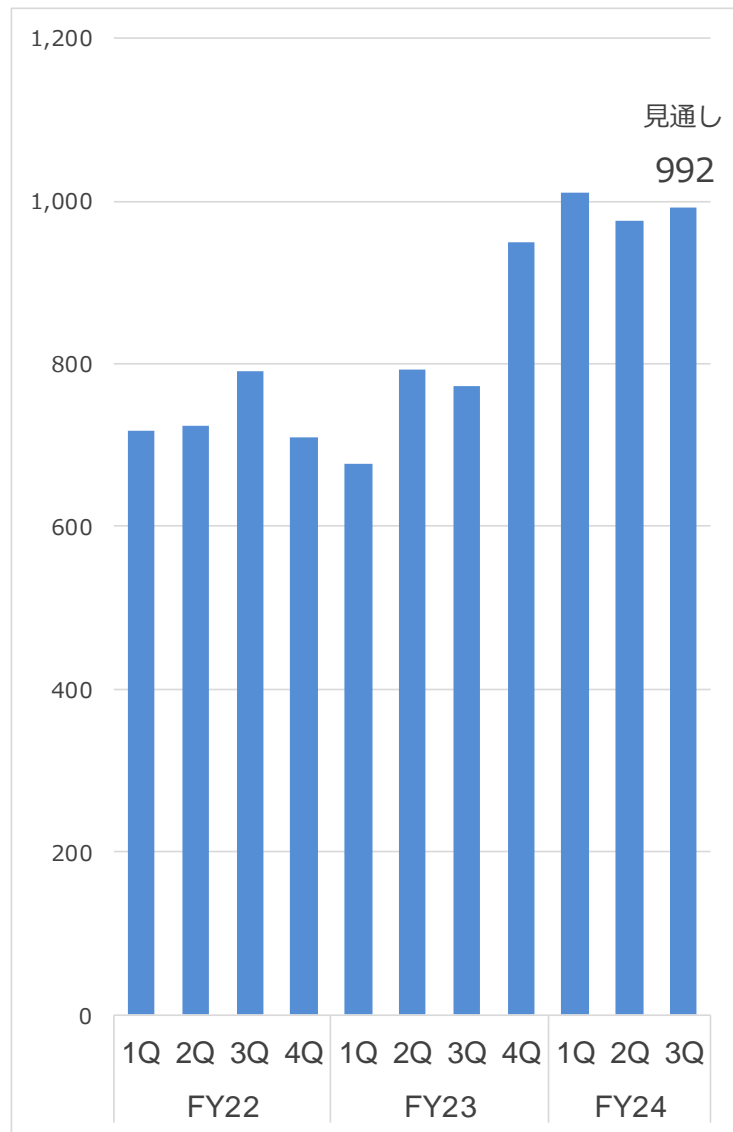


- 業績：高付加価値案件や為替恩恵でG P率70%台を記録
装置・消耗品ともに収益性が上昇
- 半期ベースの純利益・純利益率は過去最高を記録
- 上期最高益により中間配当は過去最高124円（前年76円）

半期推移（検収基準） 単位：億円



出荷額 四半期推移 (億円)



- パワー半導体は長期的成長見込むも足元のEVシフト鈍化で一服感
- 生成A I 向けは最終需要などに連動し高水準の装置出荷を見込む
- 量産用途向け装置需要は本格回復に至らず引き続き消耗品の出荷動向を注視
- 市場の繁忙や閑散に関わらず全力で「会社を強くする」取り組みを継続DISCO VALUES、Will会計、PIM活動に注力
- 高度なKKM技術の開発強化を継続新しい素材や自動化など開発テーマの増加に全力で対応中

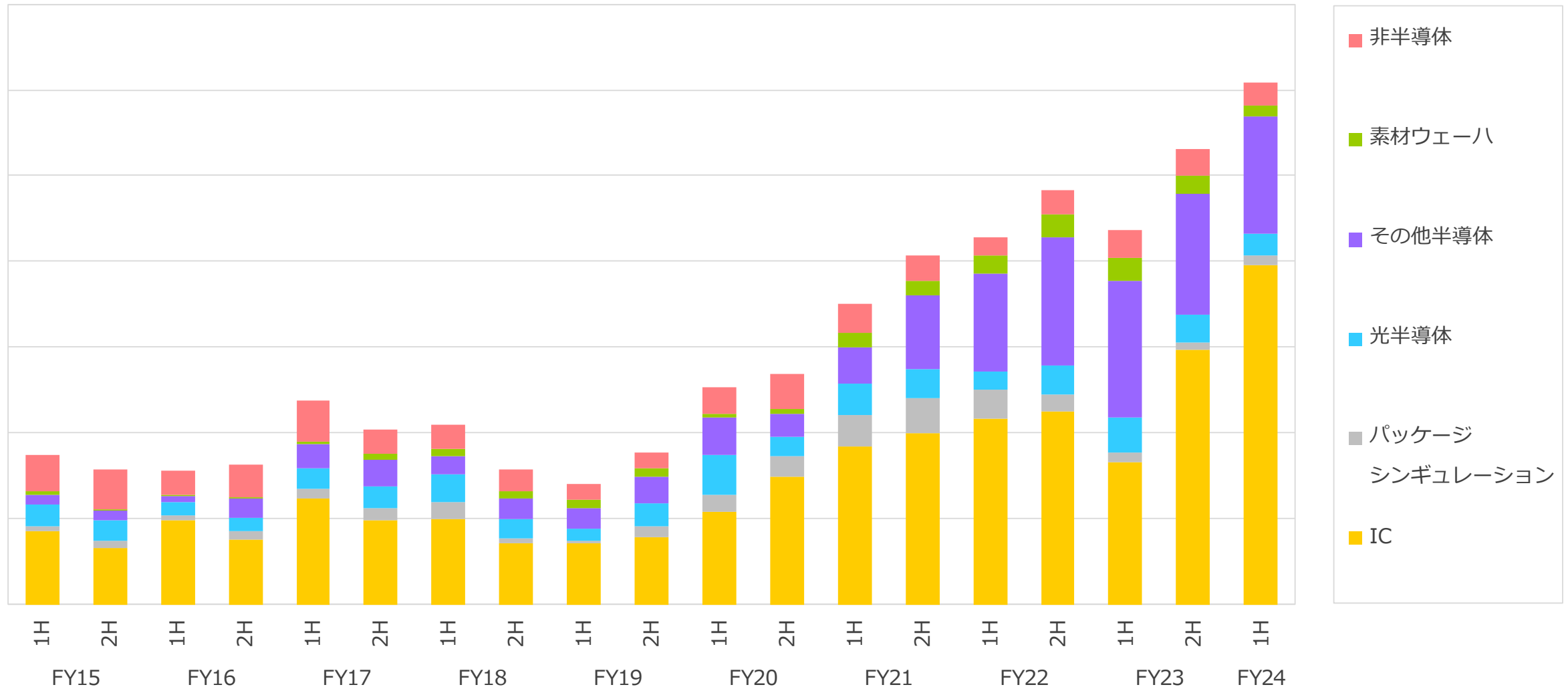
参考 半期推移 グラフ集

精密加工装置 用途別売上高

出荷額ベース

半期

精密加工装置

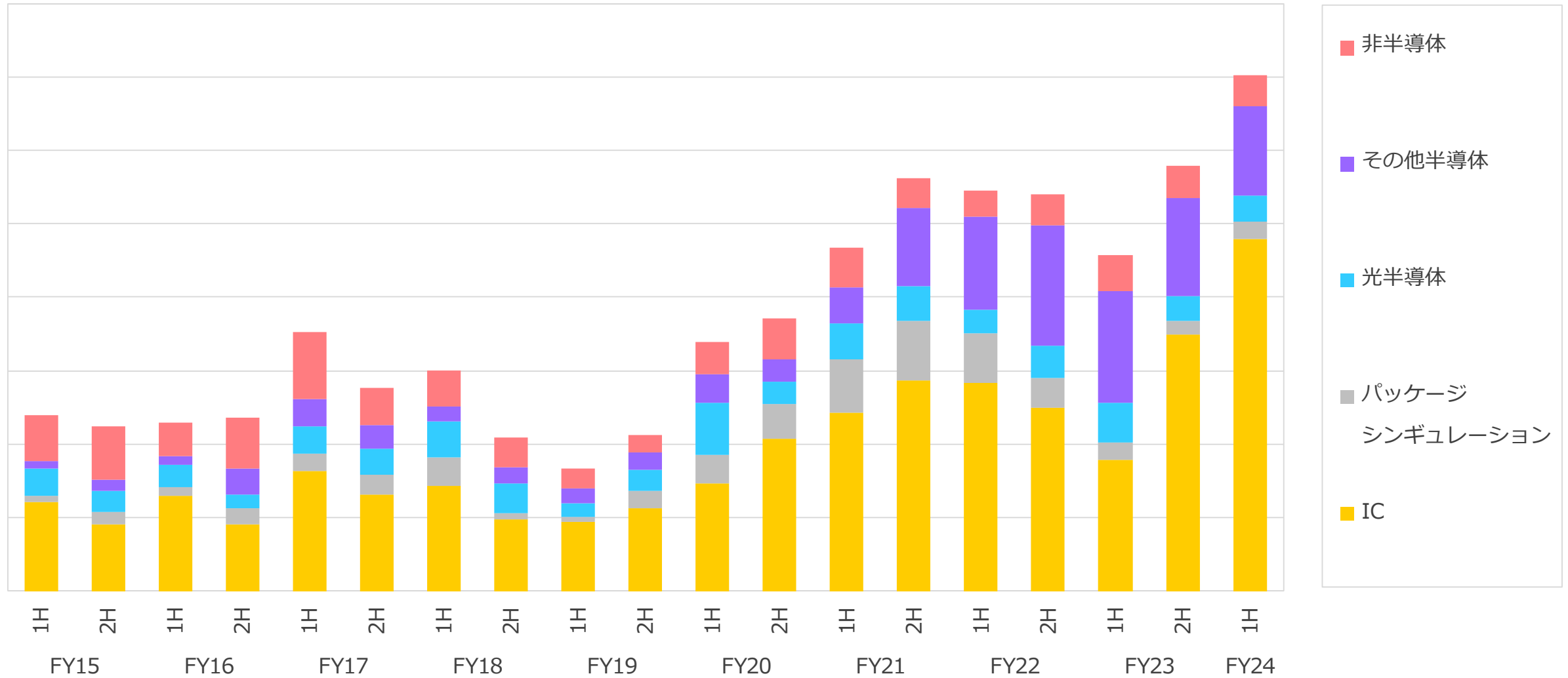


ダイサ用途別売上高

出荷額ベース

半期

ダイサ

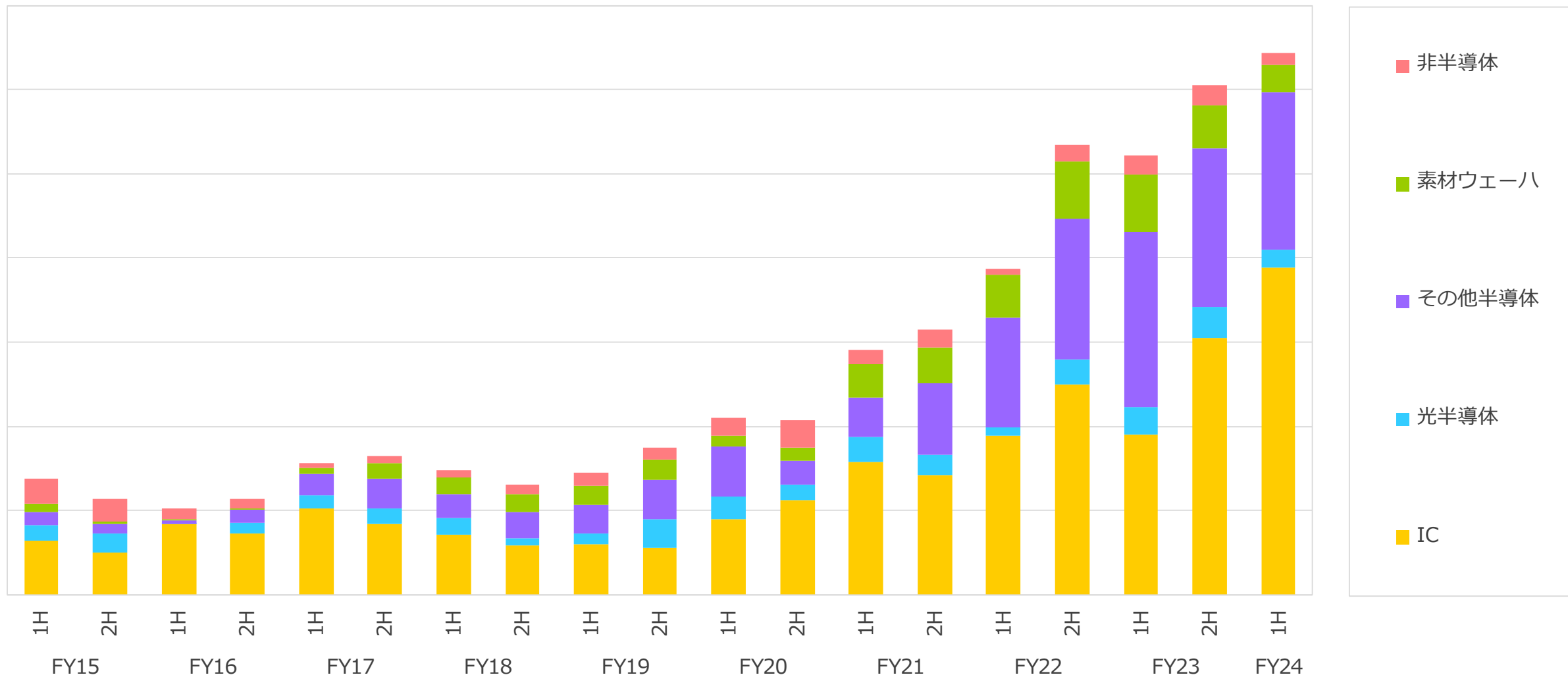


グラインダ用途別売上高

出荷額ベース

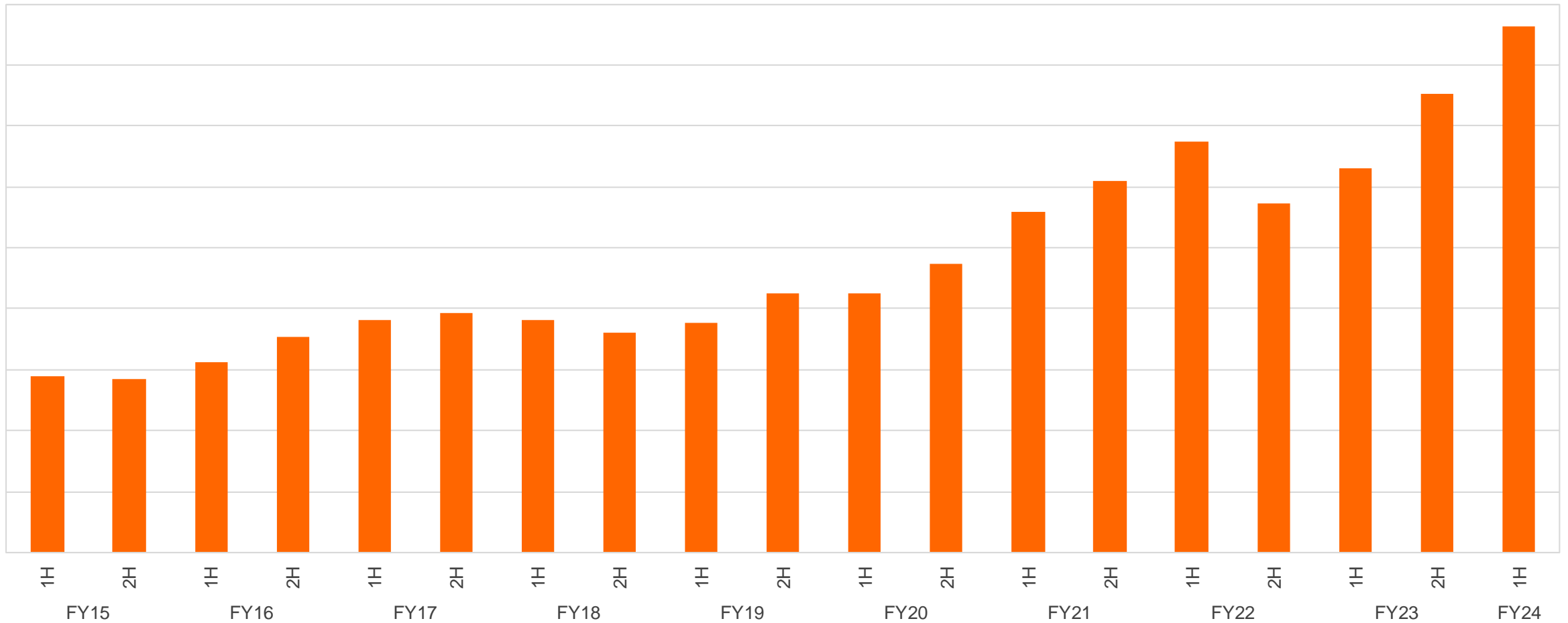
半期

グラインダ



出荷額ベース

半期



【ご参考】 製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY	構成比	YoY
	2Q	2Q	2Q	1H	1H
精密加工装置合計	65%	-5%	23%	65%	38%
内、ダイサ	35%	-7%	36%	35%	54%
ブレードダイサ	15%	-19%	10%	17%	28%
レーザソー	19%	5%	67%	18%	88%
内、グラインダ	26%	-4%	11%	26%	23%
薄化DGP	17%	-8%	51%	17%	85%
薄化以外	9%	7%	-26%	8%	-27%
内、周辺装置	4%	11%	15%	4%	23%
精密加工ツール	23%	10%	34%	22%	39%
その他	12%	-17%	4%	13%	17%
出荷額合計	100%	-3%	23%	100%	35%

出荷額ベース

		FY23				FY24	
製品	用途	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q	24-1Q	24-2Q
ダイサ	1_IC	38%	40%	60%	61%	67%	69%
	2_パッケージ・シンギュレーション	6%	4%	2%	4%	4%	3%
	3_光半導体	12%	12%	7%	5%	5%	5%
	4_その他_半導体	34%	32%	23%	23%	19%	16%
	5_非半導体	10%	11%	8%	8%	5%	7%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%	100%
グラインダ	1_IC	32%	41%	48%	52%	60%	61%
	2_光半導体	5%	7%	12%	1%	6%	1%
	3_その他_半導体	45%	36%	30%	32%	27%	31%
	4_素材ウエーハ	14%	12%	7%	10%	6%	4%
	5_非半導体	5%	4%	3%	4%	2%	3%
グラインダ		100%	100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

		FY23				FY24	
製品	用途	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q	24-1Q	24-2Q
ダイサ	1_IC	-46%	-27%	1%	94%	210%	135%
	2_パッケージ・シンギュレーション	-71%	-60%	-76%	-32%	23%	-15%
	3_光半導体	55%	81%	-28%	-18%	-26%	-46%
	4_その他_半導体	18%	23%	-37%	2%	-3%	-33%
	5_非半導体	40%	24%	-15%	35%	-17%	-13%
ダイサ		-25%	-7%	-19%	41%	75%	36%
グラインダ	1_IC	-23%	25%	-11%	69%	160%	68%
	2_光半導体	253%	207%	267%	-81%	46%	-86%
	3_その他_半導体	74%	50%	3%	22%	-16%	-4%
	4_素材ウエーハ	24%	37%	-37%	-15%	-45%	-62%
	5_非半導体	198%	244%	74%	-4%	-50%	-24%
グラインダ		24%	45%	1%	25%	37%	11%

出荷額ベース

		FY23				FY24	
製品	用途	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q	24-1Q	24-2Q
ダイサ	1_IC	-25%	26%	46%	40%	20%	-4%
	2_パッケージ・シンギュレーション	-37%	-5%	-50%	126%	14%	-34%
	3_光半導体	22%	22%	-46%	1%	10%	-12%
	4_その他_半導体	-6%	12%	-30%	39%	-11%	-22%
	5_非半導体	7%	38%	-33%	36%	-34%	46%
ダイサ		-13%	20%	-3%	39%	8%	-7%
グラインダ	1_IC	-26%	53%	15%	31%	14%	-2%
	2_光半導体	-36%	55%	70%	-89%	402%	-85%
	3_その他_半導体	21%	-3%	-20%	30%	-17%	10%
	4_素材ウエーハ	-15%	3%	-48%	85%	-45%	-29%
	5_非半導体	-23%	8%	-21%	46%	-59%	62%
グラインダ		-9%	19%	-3%	20%	-1%	-4%

検収ベース

■ 構成比	FY2023				FY2024	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
日本	13%	12%	12%	12%	9%	11%
アメリカ	10%	16%	11%	14%	15%	10%
アジア	67%	63%	66%	65%	69%	72%
シンガポール	8%	9%	7%	6%	6%	8%
台湾	15%	11%	10%	12%	16%	17%
韓国	8%	5%	9%	12%	14%	12%
中国 ※	35%	36%	38%	34%	32%	33%
その他	1%	2%	1%	0%	1%	1%
ヨーロッパ	10%	10%	11%	9%	7%	7%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む

本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY（Fiscal Year）と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。％は実際の金額を基に算出しています。

将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む）するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>